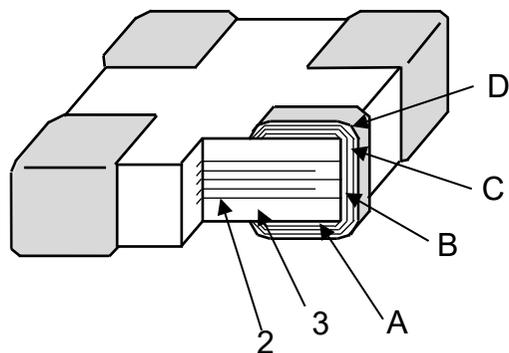


低ESL型チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表
 Structure and Material of Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<LLF0YK/LLG0YK Series>

1. 内部構造(例)/Example of Structure



2. 材料名/Material

| No. | 名称/Name | 材料/Material |
|-----|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 外部電極 Termination | A ニッケル合金 Nickel Alloy |
| | | B 銅 Copper |
| | | C ニッケル Nickel |
| | | D すず Tin |
| 2 | 内部電極 inner electrode | ニッケル Nickel |
| 3 | 誘電体素子 Dielectric layer | チタン酸バリウム系 Barium titanate-based |